

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-010

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>2025 年度深圳辖区上市公司集体接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 11 月 20 日 (周四) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、独立董事 兰才明 2、独立董事 韩燕 3、董事会秘书、财务负责人 蒋伟红 4、证券事务代表 陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1、贵公司，液冷进展什么情况了？ 答：尊敬的投资者您好！当前公司液冷散热业务正处于积极市场开拓阶段，正加快推动核心客户的量产导入进程，公司已实现小批量液冷产品订单的交付。公司目标客户群体主要包括国内头部服务器厂商、AI 算力平台建设单位以及部分外资品牌在华的 ODM/整机集成商。在客户推进方面，公司给国内厂商提供的液冷板产品因采用新技术工艺，目前处于样品测试阶段，验证周期相对较长，其中公司提供某台资企业的样品验证有望率先取得突破。此外，公司已与 superX 在新加坡设立合资公司达成战略合作，共同拓展海外液冷市场。感谢您的关注！ Q2、液冷订单有吗 答：尊敬的投资者您好！截至目前公司已有小批量液冷订单交付，

	公司将积极加快推动核心客户的量产导入进程，如后续取得重大进展，公司将严格依照相关法律法规的要求，通过临时公告或定期报告等方式及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ Q3、半导体封装材料业务主要的客户或者产品情况？未来有哪些新的客户或者产品的拓展？ 答：尊敬的投资者您好！公司半导体封装材料业务广泛涉及 MOSFET、IGBT、SiC 等 IGBT 功率模块的封装材料供应。主要客户包括国内知名的功率半导体封装企业，目前，公司正积极向行业头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，以满足新能源汽车、光伏逆变器等领域的应用需求。感谢您的关注！ Q4、想了解下公司目前专利数量和研发投入情况 答：尊敬的投资者您好！公司是“国家级专精特新‘小巨人’”、“国家高新技术企业”企业，截至上半年，公司拥有专利技术 185 项，其中发明专利 5 项，集成电路布图设计权 7 个，软件著作权 47 项，实用新型 126 个。上半年公司研发投入同比增长 9.59%。公司长期坚持结合成本效益分析，确保对基础研究、核心技术的投入保持一定的比例。未来，研发投入将更加聚焦于半导体封装材料和新拓展的液冷散热业务。感谢您的关注！ Q5、请问 2025 年前三季度业绩增长原因？ 答：尊敬的投资者您好！2025 年前三季度公司实现营业收入 3.10 亿元，同比增长 24.48%；实现归母净利润 1,242.22 万元，同比增长 2,925.45%；实现扣非后归母净利润 623.73 万元，同比增长 204.03%。业绩增长的主要原因为：（1）公司持续加大智能卡产品销售力度，依托于行业内端到端的全产业链覆盖优势，多维度拓展国内外市场，收入同比增长；（2）得益于下游功率电子应用的快速扩张，公司拓展布局的半导体封装材料产品渗透率与市场份额加速提升。公司持续产品结构优化叠加降本增效，盈利水平显著提升。感谢您的关注！ Q6、公司对液冷赛道的发展规划有哪些？
--	--

	答：尊敬的投资者您好！公司紧抓 AIDC（人工智能数据中心）建设带来的散热需求机遇，依托在高导热金属材料、精密蚀刻、电镀与钎焊等半导体封装领域积累的核心工艺，顺势切入液冷热管理赛道，致力于实现从“封装材料”到“散热结构件”再到“系统级液冷解决方案”的自然产业延伸。 在产品布局上，公司已实现液冷板、波纹管、分水器、UOD 快接头等核心组件的全栈覆盖，并积极延展开下一代微通道水冷板（MLCP）等芯片级高效散热方案，同时向 CDU 模块及整柜级二次侧液冷一体化方案拓展。 在商业模式上，公司正积极推进国内头部服务器厂商、AI 算力平台及 ODM/集成商的样品测试与量产导入，并通过与 superX 设立合资公司加速海外市场拓展。未来，公司将聚焦系统级测试平台建设及二次侧体系优化，强化全链路能力，力争使液冷业务成为新的重要增长点。感谢您的关注！ Q7、公司未来有什么业务亮点、新的利润增长点？ 答：尊敬的投资者您好！（1）在智能卡业务方面，多维度拓展国内外市场，稳住市场地位，同时紧跟行业技术发展趋势，不断拓展超级 SIM 卡创新应用场景，开拓新的业务形态；（2）公司已实现半导体封装材料的自主设计与量产落地，产品可覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 及功率模块的封装需求，得益于下游功率电子应用的快速扩张，2025 年仍然保持强劲增长态势，该业务的顺利投产对公司业绩有一定积极影响。（3）基于在高导热金属材料、蚀刻、电镀与钎焊等核心工艺的深厚积淀，公司精准把握 AIDC 建设带来的液冷散热需求，顺势切入热管理赛道。公司新兴孵化的液冷散热业务板块正处于积极市场开拓阶段，虽然截至目前该板块的相关收入占公司营收比例较低，但公司产品具备结构创新和成本优势，随着客户认可度的提升及量产计划的推进，预计在核心客户的广泛应用下实现快速增长，并有望成为公司未来重要的收入来源。感谢您的关注！
--	--

	Q8、公司未来发展战略是什么？ 答：尊敬的投资者您好！公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT 产品和数字与能源热管理产品的综合解决方案提供商，坚持以技术创新为驱动，以系统集成作为引擎，为全球客户提供高性能、低功耗、安全可信的综合解决方案。公司在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上，落实“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，持续创新、积极转型，把握智能卡行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务、信息安全业务及数字与能源热管理产品投入资源，构建多元化协同发展的业务格局。感谢您的支持与关注！ Q9、我想问一下：半年来，公司吹了无数次的液冷业务，现在毫无进展，也没有接到一个订单。是不是涉嫌是为配合大股东减持进行的虚假宣传？在未来半年内是否能接到一个 10 万元以上的液冷订单？ 答：尊敬的投资者您好！当前公司液冷散热业务正处于积极市场开拓阶段，正加快推动核心客户的量产导入进程，已产生小批量订单交付。作为新兴孵化业务，其发展遵循“样品验证-小批量订单-规模化量产”的行业规律。目前，公司正与多家头部服务器厂商及算力平台进行深入的样品测试与方案验证，并与 superX 设立了合资公司以拓展海外市场，这些扎实的前期工作是获取量产订单的重要基础。基于当前与核心客户的对接进度及反馈，公司对未来持审慎乐观态度。公司对液冷业务的披露严格遵守相关法律法规，所有信息均基于实际研发进展与市场开拓情况，不存在您所提及的违规情形。敬请投资者理性看待新兴业务的成长规律，理性投资，也请持续关注公司后续的相关公告。感谢您的支持与关注！
风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风

	险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单(如有)	无
日期	2025-11-20